

3CA6421U 型硅 PNP 高频高反压大功率晶体管

1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 SMD-0.5 型金属陶瓷封装。

器件具有特征频率高、体积小、重量轻，可靠性高的特点。

器件的静电放电敏感度为 4000V，SMD-0.5 典型重量 1.0g。



SMD-0.5

2、质量等级及执行标准

G、G+:Q/RBJ1001QZ，QJZ840611。

JCT: Q/RBJ 30025-2016，GJB33A-1997。

3、最大额定值（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。）

表 1 最大额定值

型 号	$P_{\text{tot1}}^{\text{a}}$ W	$P_{\text{tot2}}^{\text{b}}$ W	I_{CM}^{c} A	V_{CBO} V	V_{CEO} V	V_{EBO} V	T_{op} $^{\circ}\text{C}$	$T_{\text{stg}}, T_{\text{j}}$ $^{\circ}\text{C}$
3CA6421U	3	35	2	-375	-250	-6	-55~150	-65~200
^a P_{tot1} 为 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，不加散热片时的最大额定功率； $T_A>25^{\circ}\text{C}$ 时,按 17.1mW/ $^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。 ^b P_{tot2} 为 $T_C=25^{\circ}\text{C}$ 时的最大额定功率； $T_C>25^{\circ}\text{C}$ 时,按 200mW/ $^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。 ^c I_{CM} 为集电极允许耗散功率的范围内，能连续通过发射极的直流电流的最大值。								

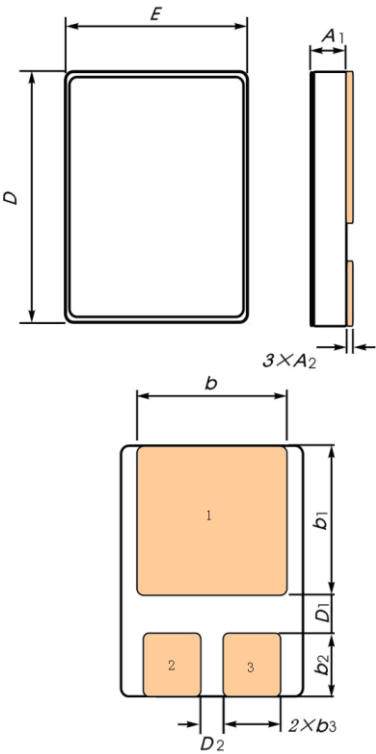
4、主要电特性

主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

参 数		数 值			单 位
符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
$V_{(\text{BR})\text{CBO}}$	$I_C=0.1\text{mA}$	-375	—	—	V
$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	$I_C=50\text{mA}$	-250	—	—	V
$V_{(\text{BR})\text{EBO}}$	$I_E=0.1\text{mA}$	-6	—	—	V
I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=-50\text{V}$	—	—	15	mA
I_{CEO}	$V_{\text{CE}}=-150\text{V}$	—	—	5	mA
I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=-6\text{V}$	—	—	0.5	mA
I_{CEX}	$V_{\text{BE}}=1.5\text{V}, V_{\text{CE}}=-450\text{V}$	—	—	1	mA
h_{FE1}	$V_{\text{CE}}=-10\text{V}, I_C=0.1\text{A}$	40	—	—	—
h_{FE2}	$V_{\text{CE}}=-2\text{V}, I_C=1\text{A}$	8	—	80	—
h_{FE3}	$V_{\text{CE}}=-10\text{V}, I_C=1\text{A}$	25	—	100	—
$V_{\text{BE}}(\text{sat})$	$I_C=1\text{A}, I_B=100\text{mA}$	—	—	-1.4	V
$V_{\text{CE}}(\text{sat})$	$I_C=1\text{A}, I_B=125\text{mA}$	—	—	-0.75	V
V_{BE}	$V_{\text{CE}}=-10\text{V}, I_C=1\text{A}$	—	—	-1.4	V

5、外形尺寸



单位为毫米

尺寸符号	最小值	最大值
D	10.04	10.36
E	7.40	7.76
A_1	2.76	3.10
A_2	0.25	0.66
b	7.14	7.41
b_3	2.24	2.59
b_1	5.59	6.44
b_2	2.88	3.22
D_1	0.76	—
D_2	0.762	—

SMD-0.5 外形尺寸

6、使用和维护

6.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大。

SMD-0.5 型金属陶瓷封装，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，否则易造成陶瓷金属裂缝，影响其密封性。

焊接安装时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

6.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按照规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。